集成电路、集成产品的焊接封装设备项目安全风险评价报告

目录

前言.....3

一、安全评价范围、目的及依据.....3

(一)、评价范围.....3

(二)、评价目的.....4

(三)、评价依据.....6

二、危险、有害因素的辨识与分析.....7

(一)、辨识与分析危险、有害因素的依据.....7

(二)、主要危险、有害物质分析.....8

(三)、生产过程中危险有害因素的辨识与分析.....9

(四)、自然条件危险、有害因素辨识与分析.....11

(五)、安全管理不当导致的危险、有害因素辨识与分析.....13

(六)、重大危险源辨识结果.....14

三、安全评价程序与评价方法.....16

(一)、安全评价程序.....16

(二)、划分评价单元.....17

(三)、确定采用的安全评价方法.....18

四、环境评价.....20

(一)、环境评价概述.....20

(二)、评价集成电路、集成产品的焊接封装设备项目概况.....20

(三)、环评单位的基本情况.....22

(四)、评价范围及目的.....24

(五)、评价依据.....25
(六)、国家环保法律法规.....25
(七)、地方环保规定.....26
(八)、相关标准和技术规范.....26
(九)、评价程序与方法.....26
(十)、环境评价程序.....26
(十一)、评价方法与技术路线.....28
五、节能减排措施.....30
(一)、节能措施.....30
(二)、减排措施.....31
(三)、清洁生产措施.....33
六、社会影响评估.....34
(一)、社会经济状况.....34
(二)、集成电路、集成产品的焊接封装设备项目对当地经济的影响.....35
(三)、集成电路、集成产品的焊接封装设备项目对当地社会的影响.....37
(四)、集成电路、集成产品的焊接封装设备项目对当地文化的影响.....39
七、资源合理利用.....41
(一)、能源利用.....41
(二)、水资源利用.....42
(三)、土地资源利用.....44
(四)、原材料资源利用.....46
(五)、其他资源的合理利用.....47

八、环境保护措施 48
(一)、大气环境保护措施 48
(二)、水环境保护措施 49
(三)、土壤环境保护措施 51
(四)、生态环境保护措施 52
(五)、噪声环境保护措施 53
九、集成电路、集成产品的焊接封装设备项目安全现状评价报告的审核与批准 54
(一)、审核程序与内容 54
(二)、审核人员 56
(三)、审核结论 58
(四)、报告批准程序 59
十、安全与环境信息披露 61
(一)、信息披露原则 61
(二)、信息披露内容 63
(三)、信息披露途径 65
(四)、信息披露周期 66
十一、环境风险应急预案 67
(一)、环境风险评估基础 67
(二)、应急预案的制定 70
(三)、应急组织和协调 72
(四)、应急物资和设备准备 74
(五)、应急演练 76

(六)、事故发生时的处置 77

十二、安全与环境考核评价 79

(一)、考核制度 79

(二)、考核内容 81

(三)、考核方法 83

(四)、考核结果分析 85

(五)、考核奖惩措施 87

十三、安全与环境问题的沟通与协调 89

(一)、内部沟通机制 89

(二)、外部协调与社会沟通 90

(三)、危机公关处理 92

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/448056042043006053